2014-2019年中国新型电子 封装材料市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制 www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国新型电子封装材料市场分析与投资前景研究报告》信息及时,资料详实,指导性强,具有独家,独到,独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势,获得优质客户信息,准确、全面、迅速了解目前行业发展动向,从而提升工作效率和效果,是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址:http://www.bosidata.com/qitadianzi1405/W450434MEE.html

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-05-27

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线:400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国新型电子封装材料市场分析与投资前景研究报告》共十四章,报告内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

新型电子封装材料是随着近年来封装技术不断发展和技术而研发出来的,现代科学技术的发展对封装材料的性能和可靠性提出了更高的要求,由此推动了新材料和新结构的研究开发。与传统封装材料相比,新型封装材料具有更大的优势。目前,主要新型封装材料有金属封装、塑料封装、陶瓷封装、玻壳封装、玻璃实体封装、金属基复合材料封装等。报告目录

第一章 新型电子封装材料行业的概述 10

第一节新型电子封装材料行业的定义和细分10

第二节 新型电子封装材料行业的基本特点 12

第三节 我国新型电子封装材料行业的发展 13

第四节 新型电子封装材料行业在国民经济的重要性 14

第五节 新型电子封装材料行业相关统计数据 15

第二章 新型电子封装材料行业发展环境分析 17

第一节 我国宏观经济环境分析 18

- 一、2012年我国宏观经济形势总结 18
- 二、2013年我国宏观经济形势分析20
- 三、&ldguo;十二五&rdguo;经济发展思考 20

第二节 新型电子封装材料行业政策环境分析 26

- 一、2012年我国宏观经济政策总结26
- 二、2013年我国宏观经济政策分析 43

- 三、新型电子封装材料行业政策及相关政策解读 44 第三节 新型电子封装材料行业技术环境分析 47
- 一、生产工艺与技术 47
- 二、技术发展趋势与方向47

第三章 2013年新型电子封装材料市场年度市场调查分析 48 第一节 2013年新型电子封装材料行业盈利能力分析 48 第二节 2013年新型电子封装材料行业偿债能力分析 50 第三节2013年新型电子封装材料行业经营效率分析 51 第四节2013年新型电子封装材料行业人均创利对比分析 52 第五节2013年新型电子封装材料行业亏损面分析 52

第四章 新型电子封装材料行业发展情况分析 53

第一节新型电子封装材料行业发展分析53

- 一、新型电子封装材料行业发展历程及现状53
- 二、新型电子封装材料行业发展特点分析 54
- 三、新型电子封装材料行业与宏观经济相关性分析 54
- 四、新型电子封装材料行业生命周期分析 55
- 第二节 新型电子封装材料行业生产情况分析 56
- 一、新型电子封装材料行业生产总量及增速分析56
- 二、新型电子封装材料行业开工情况分析 56

第三节 新型电子封装材料行业对外贸易情况 57

- 一、进口数量及增长情况57
- 二、出口数量及增长情况 57

第四节 新型电子封装材料产品价格走势分析 58

第五章 新型电子封装材料市场供需调查分析 58

第一节 2013年新型电子封装材料市场供给分析 58

- 一、市场供给分析58
- 二、价格供给分析 59
- 三、渠道供给调研59

第二节 2013新型电子封装材料市场需求分析 60

- 一、市场需求分析60
- 二、价格需求分析60
- 三、渠道需求分析61
- 四、购买需求分析61

第三节 2013年新型电子封装材料市场特征分析 61

- 一、2013年新型电子封装材料产品特征分析61
- 二、2013年新型电子封装材料价格特征分析62
- 三、2013年新型电子封装材料渠道特征62
- 四、2013年新型电子封装材料购买特征63

第四节 新型电子封装材料行业供需格局影响因素分析 63

第六章 新型电子封装材料行业经营风险分析 63

第一节新型电子封装材料行业系统风险分析64

- 一、生命周期及成长性分析64
- 二、行业扩张性分析64
- 三、行业稳定性分析65

第二节 新型电子封装材料行业供给风险分析 65

- 一、产业基本要素变化影响分析65
- 二、竞争态势变化风险分析 66

第三节 新型电子封装材料行业需求风险分析 66

- 一、产业需求潜力分析66
- 二、产业品种结构的供求平衡分析 69

第七章 新型电子封装材料行业产业链分析 69

第一节新型电子封装材料行业产业链分析69

- 一、产业链模型介绍70
- 二、新型电子封装材料产业链模型分析 70

第二节上游产业发展及其影响分析 71

- 一、上游产业发展现状71
- 二、上游产业发展趋势预测74
- 三、上游产业对新型电子封装材料行业的影响 74

第三节下游产业发展及其影响分析 75

- 一、下游产业发展现状75
- 二、下游产业发展趋势预测82
- 三、下游产业对新型电子封装材料行业的影响84

第八章 新型电子封装材料市场竞争分析及预测 85

第一节 新型电子封装材料竞争特点分析及预测 85

- 一、新型电子封装材料发展阶段评价85
- 二、新型电子封装材料垄断性分析86
- 三、新型电子封装材料进入退出壁垒分析86

第二节 新型电子封装材料竞争结构分析及预测 87

第三节 新型电子封装材料市场竞争特性 88

第九章 新型电子封装材料行业相关企业分析 88

第一节宁波康强电子股份有限公司88

- 一、企业简介88
- 二、管理状况分析 91
- 三、经营状况分析 95
- 四、主导产品分析 96
- 五、企业经营策略和发展战略分析 97
- 第二节新华锦99
- 一、企业简介99
- 二、管理状况分析 101
- 三、经营状况分析 102
- 四、主导产品分析 103
- 五、企业经营策略和发展战略分析 104

第三节 贺利氏招远贵金属材料有限公司 107

- 一、企业简介107
- 二、管理状况分析 107
- 三、经营状况分析 107
- 四、主导产品分析 109
- 五、企业经营策略和发展战略分析 110

第四节 北京达博有色金属焊料有限责任公司 111

- 一、企业简介111
- 二、管理状况分析 112
- 三、经营状况分析 112
- 四、主导产品分析 112
- 五、企业经营策略和发展战略分析 113

第五节 复合封装材料的主要供给厂家 113

- 一、中国铝业股份有限公司山东分公司 113
- 二、安徽鑫科新材料股份有限公司 115
- 第十章 新型电子封装材料行业财务风险分析 116
- 第一节 新型电子封装材料行业经济效益风险分析 116
- 一、反映经济效益的财务指标的选择 116
- 二、跨年度波动性分析 117
- 三、新型电子封装材料行业经济效益风险定位 118
- 第二节 新型电子封装材料行业资产安全风险分析 118
- 第三节 新型电子封装材料行业增值能力风险分析 119

第十一章 未来5年新型电子封装材料行业发展前景及趋势分析 120

- 第一节 未来5年新型电子封装材料行业发展趋势分析 120
- 一、行业发展分析 120
- 二、行业技术开发方向 121
- 三、总体行业"十二五"整体规划及预测 122
- 第二节 未来5年新型电子封装材料行业运行状况预测 122
- 一、行业总产值预测 122
- 二、行业销售收入预测 123
- 三、行业利润总额预测 124
- 四、2014-2019年行业总资产预测 124

第十二章 未来5年新型电子封装材料企业投资潜力与价值分析 125

第一节 新型电子封装材料企业投资环境分析 125

第二节 新型电子封装材料企业SWOT模型分析 125

- 一、优势 125
- 二、劣势 126

三、机会 127

四、威胁 128

第三节 我国新型电子封装材料企业投资潜力分析 129 第四节 我国新型电子封装材料企业前景展望分析 129 第五节 我国新型电子封装材料企业盈利能力预测 130 第六节 行业生产总量及增速预测 130

第十三章 未来5年新型电子封装材料行业投资风险展望 130

第一节 宏观调控风险 130

第二节 行业竞争风险 131

第三节 供需波动风险 131

第四节 经营管理风险 131

第五节 技术风险 131

第六节 其他风险 132

第十四章 新型电子封装材料行业发展投资策略及建议 132

第一节 新型电子封装材料企业投资策略分析 132

- 一、产品定位策略 132
- 二、产品开发策略 133
- 三、渠道销售策略 133
- 四、品牌经营策略 134
- 五、服务策略 134
- 第二节企业观点综述及专家建议 135
- 一、企业观点综述 135
- 三、博思数据投资建议 138

图表目录

图表 陶瓷基片材料的性能比较 11

图表 AIPSiC 与其他封装材料性能的比较 12

图表 2007-2013年电子元件及组件制造业主要数据 15

图表 2007-2013年电子元件及组件制造业资产负债情况 16

图表 2007-2013年电子元件及组件制造业销售毛利率统计 17

图表 2007-2013年GDP及其增速统计 18

图表 2013年月份CPI走势对比图 18

图表 2013年全国固定资产投资情况 19

图表中共中央关于十二五规划的建议 20

图表 未来几年我国新型电子封装材料技术开发方向 47

图表 2007-2013年我国新型电子封装材料行业销售毛利润走势 48

图表 2007-2013年中国新型电子封装材料利润增长速度 49

图表 2009-2013年我国新型电子封装材料行业偿债能力指标统计 50

图表 2009-2013年中国新型电子封装材料行业总资产周转率情况 52

图表 2009-2013年新型电子封装材料行业人均创利对比 52

图表 2009-2013年新型电子封装材料行业亏损企业数量变化 52

图表 我国新型电子封装材料的发展历程 53

图表 中国新型电子封装材料需求量与固定资产投资等宏观数据的统计相关性 54

图表 新型电子封装材料行业与成长期行业对比分析 55

图表 新型电子封装材料行业处干成长期 55

图表 2010-2013年中国新型电子封装材料产量统计 56

图表 2009-2013年新型电子封装材料行业开工率走势图 56

图表 2009-2013年我国新型电子封装材料进口及其增速 57

图表 2009-2013年我国新型电子封装材料出口数量及增速 58

图表 2013年新型电子封装材料市场价格季节性波动 58

图表 2013年我国新型电子封装材料供给结构 59

图表 2013年1-12月份我国新型电子封装材料主要销售渠道调查 62

图表 新型电子封装材料行业市场容量部分业内人士预测观点汇总 65

图表 LED产业链及生产流程 67

图表 2005-2013年大陆LED芯片产量 67

图表 大陆LED封装行业市场规模 68

图表 2013年我国新型电子封装材料品种结构供求平衡 69

图表 新型电子封装材料的产业链结构图 70

图表 新型电子封装材料主要上下游市场 70

图表 2010-2013年我国十种有色金属产量对比 71

图表 2013年基本金属产量统计 单位:吨72

图表上游产业对新型电子封装材料行业的影响 75

图表 全球前十大封装厂排名 单价:百万美元 76

图表 国内主要独资企业封装形式 78

图表 国内主要合资企业封装形式 79

图表 国内主要封装企业封装形式 80

图表 2007~2013年中国封装产量规模 82

图表 2007~2013年封装产值规模 82

图表 LED下游产业应用份额 83

图表 2007~2013年中国高端封装领域产值规模 84

图表 下游产业对新型电子封装材料行业的影响 85

图表 垄断危害程度指标 86

图表 2013年中国新型电子封装材料业分所有制企业竞争力评价指标统计表 87

图表 康强电子组织结构图 90

图表 2007-2013年康强电子管理费用统计 94

图表 2010-2013年康强电子主要财务指标 单位:元95

图表 康强电子营业收入占比图 97

图表 2010-2013年康强电子分产品营业收入 单位:万元 97

图表 康强电子SWOT分析 98

图表 新华锦与实际控制人之间的产权关系图 100

图表新华锦基本情况100

图表 2007-2013年新华锦管理费用统计 101

图表 2010-2013年新华锦主要财务指标 单位:元 102

图表 2010-2013年新华锦分产品营业收入 单位: 万元 103

图表 BGA 锡球产业链 104

图表 新华锦发展战略 104

图表 新华锦BGA 和CSP 锡球主要技术指标 106

图表 2013年贺利氏招远贵金属材料有限公司主要财务指标 108

图表掺杂型键合金线: 109

图表改良型键合金线: 110

图表 贺利氏招远贵金属材料有限公司SWOT分析 111

图表 北京达博有色金属焊料有限责任公司SWOT 113

图表 2010-2013年安徽鑫科新材料股份有限公司主要财务指标 单位:元115

图表 2007-2013年我国新型电子封装材料行业跨年度波动性指标统计 117

图表 2007-2013年新型电子封装材料行业跨年度波动性图 118

图表 2009-2013年我国新型电子封装材料行业资产负债率走势图 119

图表 2009-2013年新型电子封装材料行业资本保值增值率对比 119

图表 2014-2019年我国溴氨酸行业发展趋势 120

图表 2014-2019年新型电子封装材料工业总产值预测图 122

图表 2014-2019年新型电子封装材料产品销售收入预测图 123

图表 2014-2019年新型电子封装材料总资产预测图 124

图表 国家支持行业发展的法规和政策 125

图表 我国新型电子封装材料行业发展的推动因素 127

图表 2015年我国新型电子封装材料行业投资份额构成预测 129

图表 2014-2019年我国新型电子封装材料行业盈利能力指标预测 130

图表 新型电子封装材料企业竞价时考虑的主要因素 137

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问:http://www.bosidata.com/qitadianzi1405/W450434MEE.html